

合作金庫商業銀行

主辦南茂科技股份有限公司新臺幣壹佰貳拾億元聯合授信簽約典禮

107.05.15 發布新聞登記簿字第 022 號

南茂科技股份有限公司新臺幣壹佰貳拾億元聯合授信簽約典禮

於5月15日（星期二）上午10時30分假合作金庫總行舉行

由合作金庫商業銀行統籌主辦之南茂科技股份有限公司新臺幣120億元聯貸案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，最終以1.75倍超額認購完成募集，並於5月15日舉行聯貸簽約儀式，本次聯貸案授信用途主要為償還金融機構既有負債及充實中期營運週轉金，參與融資的銀行計有11家，由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦及額度管理銀行。

南茂科技股份有限公司為國內專業積體電路封裝測試大廠，於新竹科學園區、竹北、湖口及台南科學園區分別設有專業金凸塊、測試及封裝廠，主要從事提供高密度、高層次記憶體產品及液晶顯示器驅動IC之封裝及測試服務。南茂科技股份有限公司長期專注於半導體封裝測試領域相關之技術研發及生產，提供客戶記憶體IC、LCD驅動IC、邏輯混合訊號IC及晶圓凸塊製造等產品封裝及測試一元化服務，為台灣記憶體封裝測試領導廠商，其中液晶顯示器驅動IC封裝測試產能排名更達全世界第二位。

